



2024年7月期 第3四半期決算短信(日本基準)(非連結)

2024年6月7日

上場会社名 サムコ 株式会社

上場取引所 東

コード番号 6387 URL <https://www.samco.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 川邊 史

問合せ先責任者 (役職名) 取締役 執行役員 管理統括部長 (氏名) 宮本 省三

TEL 075-621-7841

四半期報告書提出予定日 2024年6月10日

配当支払開始予定日

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無

四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 2024年7月期第3四半期の業績(2023年8月1日～2024年4月30日)

(1) 経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2024年7月期第3四半期	5,759	3.3	1,291	1.8	1,384	2.6	972	0.6
2023年7月期第3四半期	5,576	30.7	1,314	73.1	1,349	60.7	966	65.5

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
2024年7月期第3四半期	121.05	
2023年7月期第3四半期	120.36	

(2) 財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2024年7月期第3四半期	15,866	11,751	74.1	1,463.06
2023年7月期	14,795	11,144	75.3	1,387.39

(参考)自己資本 2024年7月期第3四半期 11,751百万円 2023年7月期 11,144百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2023年7月期		0.00		45.00	45.00
2024年7月期		0.00			
2024年7月期(予想)				45.00	45.00

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 2024年7月期の業績予想(2023年8月1日～2024年7月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	8,500	8.5	1,990	7.0	2,010	4.3	1,370	0.3	170.56

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

注記事項

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無

以外の会計方針の変更 : 無

会計上の見積りの変更 : 無

修正再表示 : 無

(3) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)	2024年7月期3Q	8,042,881 株	2023年7月期	8,042,881 株
期末自己株式数	2024年7月期3Q	10,441 株	2023年7月期	10,405 株
期中平均株式数(四半期累計)	2024年7月期3Q	8,032,469 株	2023年7月期3Q	8,032,660 株

四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的と判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、上記の予想の前提条件その他に関する事項については、[添付資料] 3ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3)業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期貸借対照表	4
(2) 四半期損益計算書	7
第3四半期累計期間	7
(3) 四半期財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	8
(セグメント情報等)	8
3. 補足情報	9
(1) 受注及び販売の状況	9

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第3四半期累計期間における世界経済は、緩やかな成長が続いているものの、欧米諸国の政策金利動向、中国における不動産市況の停滞に伴う景気の減速、ウクライナや中東情勢等、先行き不透明な状況が続いております。

半導体等電子部品業界におきましては、コロナ禍で拡大したスマートフォンやパソコンなどの需要減速に伴い部品メーカーの稼働率が低下し、足元における設備投資は鈍化したしました。一方、当社の関わる化合物半導体及び電子部品製造装置の販売マーケットにおいては、5G（第5世代移動通信システム）の普及に伴いその「高速・大容量」「低遅延」「多接続」という特色を生かした新たな事業領域での開発投資が幅広い企業で進み、本格生産への移行が着実に進んでおります。加えて、不透明さを増す国際情勢を背景に、各国が自国での半導体産業育成の取り組みを強化しており、半導体等電子部品製造装置の需要は拡大しております。

このような状況の下、当第3四半期累計期間における業績は、売上高が5,759百万円（前年同期比3.3%増）、営業利益は1,291百万円（前年同期比1.8%減）、経常利益は1,384百万円（前年同期比2.6%増）、四半期純利益は972百万円（前年同期比0.6%増）となりました。

(用途別売上高)

用途	売上高(千円)	構成比(%)	前年同期比(%)
化合物半導体分野	2,248,656	39.0	40.5
シリコン半導体分野	1,021,262	17.7	50.3
電子部品分野	384,230	6.7	△47.9
ヘルスケア関連分野	64,338	1.1	△45.9
その他	1,065,718	18.5	0.1
部品・メンテナンス	975,071	16.9	△29.1
合計	5,759,277	100.0	3.3

なお、当第2四半期より事業実態をより分かりやすく反映させるため、用途区分を下記のとおり変更しております。

用途	概要
化合物半導体分野	GaN、GaAs、InP、SiCなどの化合物を材料に用いた半導体デバイスの加工用途であります。化合物半導体はLEDや半導体レーザーといった光デバイス、電力の制御や増幅に使われるパワーデバイスや高速通信を実現するHEMT (High Electron Mobility Transistor=高電子移動度トランジスタ) などの高周波デバイスに用いられます。
シリコン半導体分野	シリコンウェハの欠陥解析及びシリコン半導体に関する加工用途であります。
電子部品分野	半導体を除く電子部品の加工用途であります。主にMEMS (Micro Electro Mechanical Systems=微小電気機械システム)、コンデンサ、インダクタ、各種センサー、高周波フィルターが含まれます。
ヘルスケア関連分野	マイクロ流体デバイスなどヘルスケアに関する加工用途であります。
その他	大学等の共用設備向けの装置など上記以外の加工用途であります。
部品・メンテナンス	部品・メンテナンスに関する売上であります。

(2) 財政状態に関する説明

① 当第3四半期末の資産、負債及び純資産の状況

(流動資産)

当第3四半期会計期間末における流動資産の残高は、11,127百万円で前事業年度末に比べ952百万円増加いたしました。売掛金及び契約資産が949百万円減少した一方、現金及び預金が1,603百万円、棚卸資産が300百万円増加したのが主な要因であります。

(固定資産)

当第3四半期会計期間末における固定資産の残高は、4,738百万円で前事業年度末に比べ119百万円増加いたしました。機械及び装置が60百万円、保険積立金が20百万円、建設仮勘定が16百万円増加したのが主な要因であります。

(流動負債)

当第3四半期会計期間末における流動負債の残高は、3,149百万円で前事業年度末に比べ473百万円増加いたしました。未払法人税等が270百万円減少した一方、短期借入金が300百万円、契約負債が293百万円増加したのが主な要因であります。

(固定負債)

当第3四半期会計期間末における固定負債の残高は、964百万円で前事業年度末に比べ10百万円減少いたしました。長期借入金が29百万円減少したのが主な要因であります。

(純資産)

当第3四半期会計期間末における純資産の残高は、11,751百万円で前事業年度末に比べ607百万円増加いたしました。繰越利益剰余金が610百万円増加したのが主な要因であります。自己資本比率は74.1%と前事業年度末に比べ1.2ポイント低下いたしました。

(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明

2024年7月期の業績予想につきましては、第3四半期累計の実績及び足元の受注、生産、出荷状況を勘案し、2023年9月11日に発表いたしました通期の業績予想数値に修正はありません。

2. 四半期財務諸表及び主な注記

(1) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

	前事業年度 (2023年7月31日)	当第3四半期会計期間 (2024年4月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	5,301,752	6,905,645
受取手形	12,252	—
電子記録債権	182,574	125,109
売掛金及び契約資産	2,489,827	1,540,059
製品	—	67,083
仕掛品	1,741,835	1,957,410
原材料及び貯蔵品	428,537	446,066
前払費用	9,815	26,664
その他	29,974	80,559
貸倒引当金	△20,984	△20,688
流動資産合計	10,175,585	11,127,910

(単位:千円)

	前事業年度 (2023年7月31日)	当第3四半期会計期間 (2024年4月30日)
固定資産		
有形固定資産		
建物	1,113,037	1,117,699
減価償却累計額	△824,645	△843,940
建物(純額)	288,392	273,758
構築物	27,100	27,100
減価償却累計額	△25,093	△25,227
構築物(純額)	2,007	1,873
機械及び装置	689,649	771,795
減価償却累計額	△670,345	△691,522
機械及び装置(純額)	19,303	80,272
車両運搬具	56,314	57,338
減価償却累計額	△52,778	△48,593
車両運搬具(純額)	3,536	8,744
工具、器具及び備品	256,030	278,823
減価償却累計額	△233,988	△243,532
工具、器具及び備品(純額)	22,042	35,291
土地	3,453,567	3,453,567
リース資産	50,790	57,983
減価償却累計額	△50,790	△49,580
リース資産(純額)	—	8,403
建設仮勘定	74,611	90,867
有形固定資産合計	3,863,459	3,952,778
無形固定資産		
電話加入権	2,962	2,962
ソフトウェア	1,402	10,969
ソフトウェア仮勘定	—	5,000
無形固定資産合計	4,364	18,932
投資その他の資産		
投資有価証券	300,794	299,637
関係会社株式	25,207	25,207
出資金	5,000	5,000
関係会社長期貸付金	12,150	5,165
繰延税金資産	129,893	131,221
差入保証金	78,378	79,047
保険積立金	199,206	219,347
その他	991	2,194
投資その他の資産合計	751,621	766,820
固定資産合計	4,619,445	4,738,530
資産合計	14,795,031	15,866,440

(単位:千円)

	前事業年度 (2023年7月31日)	当第3四半期会計期間 (2024年4月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	861,405	1,010,241
短期借入金	700,000	1,000,000
1年内返済予定の長期借入金	39,996	39,996
リース債務	—	1,939
未払金	126,249	128,701
未払費用	43,846	47,830
未払法人税等	411,448	140,568
契約負債	335,648	629,524
預り金	39,874	25,565
賞与引当金	25,500	61,700
役員賞与引当金	30,000	36,230
製品保証引当金	18,000	17,600
その他	44,069	9,932
流動負債合計	2,676,039	3,149,828
固定負債		
長期借入金	103,343	73,346
リース債務	—	6,464
退職給付引当金	476,640	480,521
役員退職慰労引当金	394,752	403,686
その他	—	646
固定負債合計	974,736	964,664
負債合計	3,650,775	4,114,492
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,663,687	1,663,687
資本剰余金		
資本準備金	2,079,487	2,079,487
資本剰余金合計	2,079,487	2,079,487
利益剰余金		
利益準備金	59,500	59,500
その他利益剰余金		
別途積立金	4,367,000	4,367,000
繰越利益剰余金	2,837,418	3,448,337
利益剰余金合計	7,263,918	7,874,837
自己株式	△13,453	△13,656
株主資本合計	10,993,640	11,604,354
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	150,615	147,593
評価・換算差額等合計	150,615	147,593
純資産合計	11,144,255	11,751,948
負債純資産合計	14,795,031	15,866,440

(2) 四半期損益計算書
(第3四半期累計期間)

(単位：千円)

	前第3四半期累計期間 (自 2022年8月1日 至 2023年4月30日)	当第3四半期累計期間 (自 2023年8月1日 至 2024年4月30日)
売上高	5,576,672	5,759,277
売上原価	2,784,942	2,906,665
売上総利益	2,791,730	2,852,611
販売費及び一般管理費	1,476,975	1,560,901
営業利益	1,314,754	1,291,710
営業外収益		
受取利息	225	159
受取配当金	21,708	2,660
為替差益	1,189	77,389
受取賃貸料	8,557	8,333
補助金収入	1,904	1,822
雑収入	4,066	6,259
営業外収益合計	37,650	96,624
営業外費用		
支払利息	3,146	3,337
固定資産除却損	0	0
営業外費用合計	3,146	3,337
経常利益	1,349,258	1,384,997
税引前四半期純利益	1,349,258	1,384,997
法人税等	382,382	412,618
四半期純利益	966,876	972,379

(3) 四半期財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

(税金費用の計算)

税金費用については、当第3四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社は、半導体等電子部品製造装置の製造及び販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

3. 補足情報

(1) 受注及び販売の状況

当社は、半導体等電子部品製造装置の製造及び販売事業の単一セグメントであるため、受注及び販売の状況につきましては、当社の品目別及び地域別に記載しております。

① 受注実績

(単位：千円)

区 分 (品目別)	前第3四半期累計期間 (自 2022年8月1日 至 2023年4月30日)		当第3四半期累計期間 (自 2023年8月1日 至 2024年4月30日)		前事業年度 (自 2022年8月1日 至 2023年7月31日)	
	受注高	受注残	受注高	受注残	受注高	受注残
CVD装置	710,872	864,297	1,336,011	1,348,755	1,293,600	1,147,975
エッチング装置	3,885,748	3,931,399	3,250,772	3,519,928	4,742,346	3,462,025
洗浄装置	645,443	478,520	284,923	153,423	755,993	324,606
部品・メンテナンス	1,135,430	554,353	792,403	301,349	1,429,529	484,018
合計	6,377,496	5,828,569	5,664,110	5,323,457	8,221,470	5,418,624

(注) 金額は販売価格によっております。

② 販売実績

(単位：千円)

区 分 (品目別)	前第3四半期累計期間 (自 2022年8月1日 至 2023年4月30日)		当第3四半期累計期間 (自 2023年8月1日 至 2024年4月30日)		前事業年度 (自 2022年8月1日 至 2023年7月31日)	
	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)
CVD装置	1,000,375	17.9	1,135,230	19.7	1,299,424	16.6
エッチング装置	2,631,131	47.2	3,192,869	55.4	3,957,103	50.5
洗浄装置	569,143	10.2	456,105	7.9	833,607	10.6
部品・メンテナンス	1,376,022	24.7	975,071	16.9	1,740,456	22.2
合計	5,576,672	100.0	5,759,277	100.0	7,830,591	100.0

(注) 主な輸出地域、輸出販売高及び割合は次のとおりであります。

(単位：千円)

区 分 (地域別)	前第3四半期累計期間 (自 2022年8月1日 至 2023年4月30日)		当第3四半期累計期間 (自 2023年8月1日 至 2024年4月30日)		前事業年度 (自 2022年8月1日 至 2023年7月31日)	
	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)
アジア	1,564,929	77.2	2,036,130	79.5	2,103,530	78.3
北米	397,648	19.6	523,347	20.4	445,802	16.6
欧州	63,844	3.2	2,773	0.1	64,449	2.4
その他	—	—	171	0.0	71,347	2.7
輸出販売高合計	2,026,422 (36.3%)	100.0	2,562,423 (44.5%)	100.0	2,685,128 (34.3%)	100.0

(注) () 内は総販売実績に対する輸出販売高の割合です。